

# L'option GlobalFoundries étudiée par Apple pour les SoC Ax

Alors que toutes les sources estimaient qu'un [accord entre TSMC et Apple](#) sur la fabrication des futures puces de la série Ax avait été signé, un feu croisé de rumeurs plaide également en faveur d'un partenariat avec GlobalFoundries.

## L'option GlobalFoundries étudiée

La firme de Cupertino serait parvenue, selon [CNET.com](#), à un accord avec l'ancienne division d'AMD au sujet de sa dernière *fab* située dans le Comté de Saratoga dans l'Etat de New York.

En fin de semaine dernière déjà, le site [SemiAccurate](#) semait déjà le trouble sur l'intérêt porté par Apple sur la dernière *fab* de GloFo.

IBM, GlobalFoundries, Samsung Electronics et d'autres partenaires ont développé des *process* en commun dans le cadre de l'*IBM Technology Development Alliance*. On notera qu'Intel et TSMC font également partie de cette alliance.

Toujours est-il qu'une même puce pourrait donc être gravée indifféremment dans une *fab* Samsung ou bien GloFo. Précisément, ce partenariat pourrait compléter la production de puces Ax produites par Samsung dans sa *fab* située au Texas, les deux sociétés étant liées jusqu'en 2014.

C'est précisément la Fab 8 qui pourrait hériter d'une partie de la production de futures puces Ax. Les sources évoquent jusqu'à une **co-entreprise entre Apple et GloFo** relative à cette *fab* à 6 milliards de dollars qui peine à remplir ses lignes de production d'une capacité de 60 000 *wafers* par mois depuis sa mise en service en 2011.

## Des partenariats croisés

Un tel partenariat ne serait donc pas contradictoire avec l'information selon laquelle Apple aurait récemment signé un partenariat avec TSMC pour la production des futurs SoC Ax, à commencer par l'A8 en 20 nm.

Le pourtour de ce potentiel partenariat reste toutefois encore flou lorsqu'on découvre qu'[UMC](#) pourrait y être lié d'une manière ou d'une autre. Le fondateur sud-coréen a [renforcé son implication](#) avec le groupe *IBM Technology Development Alliances* dans le cadre du développement de la technologie CMOS 10 nm à transistors tridimensionnels FinFET. Mais UMC entend également imposer son *process* 14 nm dont le développement avait également été initié avec l'alliance d'IBM.

Avec des partenariats croisés, Apple assurerait ainsi un volume de production substantiel pour ses futurs SoC Ax et ne serait plus dépendant d'un seul fondeur comme c'est le cas actuellement avec Samsung Electronics.